



证券代码：300567

证券简称：精测电子

编号：2026-007

武汉精测电子集团股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒其他__电话会议__
参与单位名称及人员姓名	华西证券、长江证券、国联民生、华源证券、财通证券、申银万国、广发证券、中泰证券、西部证券、华泰证券、平安证券、国泰海通、中信证券、招商证券、浙商证券、国信证券、中信建投、山西证券、方正证券、华福证券、光大证券、国金证券、长城证券、开源证券、国海证券、东方财富、东吴证券、天风证券、中邮证券、国元证券、兴业证券、嘉实基金、兴业基金、摩根士丹利、光大保德信、摩根大通、申万菱信、长盛基金、富安达基金、中信建投、华宝基金、易米基金、银华基金、长安基金、西南证券、南方基金、广发基金、中加基金、中银基金、新华基金、上银基金、中信保诚基金、西部利得基金、鹏华基金、农银汇理基金、太平基金、天治基金、东北证券、创金合信基金、泓德基金、国泰基金、上海恒复投资、中环资产、杭州君煦投资、名禹资管、上海微丰资管、上海恒穗资管、华杉资管、宁波宝隼资管、上海博笃投资、尚诚资管、上海清淙投资、华宝信托、杭州中舍资管、开弦资管、北京泽铭投资、正兴私募、鑫翰资管、君和立成资管、上海康橙资管、上海睿郡资管、高维私募、巨杉(上海)资管、海南鸿盛私募、深圳珞瑜私募、国投证券、东吴人寿、工银安盛资管、合众资管、野村投资、臻远基金、恒洵投资、凯基证券、清池资本（香港）、韶夏投资、上海勤远私募、中航证券、国新证券、东亚前海证券、华安证券、爱建证券、财达证券、工银瑞信



精测电子投资者关系活动记录表（2026 年度）

	基金、浦银安盛基金、誉辉资本、中国人寿、陆家嘴国际信托等 200 余家机构（排名不分先后）
时间	2026 年 8 月 27 日
地点	武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路 2 号公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、显示及新能源事业群总经理：刘荣华先生 董事、副总经理、董事会秘书：刘炳华先生 财务负责人：游丽娟女士 上海精测投融资总监：李国先生 证券事务代表：程敏女士
投资者关系活动主要内容介绍	Q1：公司 2026 年半年度主要经营情况介绍。 A：报告期内，公司紧抓半导体设备国产化替代的关键窗口期，持续巩固并提升在半导体量检测领域的国内领先地位，进一步加大对先进制程领域（28nm 以下）的研发投入与产品布局，公司明场缺陷检测、无图形暗场缺陷检测设备等新产品研发及产业化取得显著进展。伴随产品迭代优化，设备整机成熟度持续提升，供应链核心零部件实现进一步完善与稳定；公司新取得头部客户明场缺陷检测 14nm 工艺节点相关订单，标志着该类产品在先进制程领域的市场应用实现进一步突破，为后续先进制程设备的业务拓展奠定基础。随着前期高强度研发投入逐步进入业绩兑现阶段，公司技术产业化进程全面提速，半导体领域主营产品均实现规模化量产，交付能力大幅增强。与此同时，公司持续优化业务结构、提升经营效率，推动半导体板块盈利能力显著改善，新签订单相较去年同期实现大幅增长。2026 年上半年，国内本土面板厂商依托 LCD 面板价格上行、行业供需格局修复和高端产品结构升级，加之 OLED 赛道迈入集中布局建设期，国内企业加紧抢占中尺寸 OLED 市场份额，面板企业盈利水平普遍回暖。报告期内，公司平板显示检测业务延续快速增长态势，叠加客户结构与产品结构的持续优化，业务毛利率稳中有升，盈利能力维持较强水平。在新能源业务板块方面，报告期内，公司新能源板块



持续优化产品结构、深化生产精益管控，推动成本稳步下降、营收持续增长，成功实现扭亏为盈，经营基本面持续改善。后续公司将针对性优化调整整体业务结构，集中资源聚焦半导体等核心优势领域，聚力做强主业，进一步提升整体经营效益。

报告期内，公司实现营业收入 181,187.65 万元，同比增长 31.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,503.49 万元，同比增长 171.21%；报告期末公司总资产为 1,322,833.82 万元，较期初增长 13.52%；归属于上市公司股东的净资产为 581,791.22 万元，较期初增加 34.00%。

Q2：公司各个板块在手订单情况。

A：截至《2026 年半年度报告》披露日，公司取得在手订单金额总计约 55.89 亿元，较上年同期增长 54.89%；其中，半导体领域在手订单约 36.09 亿元，较上年同期增长 98.00%；显示领域在手订单约 12.28 亿元，较上年同期减少 14.68%；新能源领域在手订单约 7.52 亿元，较上年同期增长 117.22%。半导体领域在手订单占公司订单比例已近七成，半导体业务已成为公司经营业绩的核心支撑。

Q3：2026 年半年度公司研发投入情况如何？

A：报告期内，公司继续保持研发投入强度，研发投入 39,124.73 万元，较上年同期增长 22.27%，占营业收入 21.59%。其中，半导体量检测领域研发投入 22,694.69 万元，较上年增长 36.30%；显示检测领域研发投入 14,716.78 万元，较上年同期增长 12.91%；新能源领域研发投入 1,713.26 万元，较上年下降 26.01%。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已取得 2,731 项专利（其中 1,304 项发明专利、1,017 项实用新型专利、410 项外观设计）、402 项软件著作权、11 项软件产品登记证书、95 项商标（其中国际商标 26 项）。

Q4：公司半导体量检测领域发展现状如何？

A：公司目前在半导体领域的主营产品分为前道量检测设备、



后道电测检测设备、先进封装量检测设备和核心器件等，包括膜厚量测系统、光学关键尺寸量测系统、电子束缺陷检测系统、半导体硅片应力测量设备、明场光学缺陷检测设备和自动检测设备（ATE）等，用于晶圆加工、制造、封测环节的物理参数测量与电性性能检测，是先进制程良率管控核心装备。

报告期内，公司半导体领域订单、营收均主要来源于前道量检测领域，前道量检测领域订单、营收占半导体领域整体九成以上，后道检测等领域处于市场导入深化阶段，占公司半导体领域营收和订单的比例较低。报告期内公司在整个半导体板块实现销售收入 64,447.33 万元，较上年同期增长 14.55%；归母净利润 4,996.30 万元，较上年同期减少 31.40%（报告期内，公司进一步增加半导体领域核心资产上海精积微的持股比例，上海精积微现阶段仍处于高速投入期，致使归母净利润相较上年同期减少约 3,000 万元）；公司在半导体领域毛利率为 48.75%，较上年同期基本持平。截至公司《2026 年半年度报告》披露日，公司在半导体领域在手订单约 36.09 亿元，较上年同期增长 98.00%，半导体领域在手订单占公司到手订单比例已近七成，半导体业务已成为公司经营业绩的核心支撑。

公司半导体前道量测领域膜厚系列产品、OCD 设备、电子束设备、半导体硅片应力测量设备、明场光学缺陷检测设备等核心产品均处于国内行业领先地位，其中膜厚系列产品、OCD 设备、电子束设备等部分主力产品已完成 7nm 先进制程的交付及验收，目前更加先进制程的产品正在研发中。报告期内，公司应用于先进制程领域（28nm 以下，不含 28nm）新签订单占半导体领域新签订单超七成，先进制程产品占公司整体营收和订单的比例不断增加，现已成为公司半导体前道量检测领域业绩的核心驱动力。

公司聚焦 ATE 领域持续深耕，构建起覆盖先进存储和 SOC（系统级芯片）全场景测试体系，为不同领域客户提供定制化、高效可靠的系统测试解决方案。面向先进存储芯片，可提供集成 BI



（Burn-In）测试、CP（Chip Probing）测试和 FT（Final Test）测试于一体的多场景测试方案，全面支持最新的 DDR5/LPDDR5/NAND FLASH/UFS 等多种存储器芯片。同时针对 AI 领域的高带宽存储（HBM），推出 JH5520 HBM BI 测试系统，精准满足高端存储测试需求。面向系统级芯片，覆盖 50W~1000W 功率级别的芯片功能、性能及可靠性的测试。相关产品进展详见公司《2026 年半年度报告》。

在先进封装量检测领域，公司于 2024 年 3 月通过投资湖北星辰深度布局半导体先进封装领域，目前在高密度先进封装领域通过自主创新实现技术自主可控，关键指标达到国内领先水平。湖北星辰已建成 12 英寸集成电路先进封装研发线，正在建设量产产线，并同步推进产品研发与客户导入。湖北星辰对标国际领先先进封装工艺平台，持续开展技术研发与攻关，已同时具备中、高密度先进封装全套工艺技术，并在互联间距、互联密度、功耗等方面拥有领先优势，可为多类应用场景需求下不同领域客户提供产品定制化解决方案。

随着先进封装装备技术快速迭代，部分前道工艺向封装环节延伸，拉动半导体前道量检测、刻蚀、薄膜沉积、键合等设备的需求。面对 2.5D/3D 等先进封装挑战，公司现有前道量检测设备（主要包括膜厚系列产品、OCD 设备、电子束设备、明场光学缺陷检测设备等核心产品，具体详见前道量检测设备相关产品情况）已全部导入先进封装产线。

此外，公司晶圆外观检测设备主要专注于 CMOS 图像传感器、AR/VR、Logic、MEMS、Memory、RF、Power、FOWLP、WLCSP、Bumping、Chiplet 等先进封装工艺的有图形硅晶圆和无图像玻璃晶圆检测，已完成小批量出货，目前正在积极开发面向先进制程的 3D 量测，并与国内头部客户进行紧密验证测试。针对晶圆亚微米级缺陷进行检测与量测，集成高精度明暗场成像技术和专业缺陷检测算法，同时可扩展升级到晶圆 Bumping 及 Mirco-LED 3D 量测，



有效服务客户提升制造能力指数与生产效率，精准适配先进封装快速发展带来的复杂缺陷检测需求。

Q5：公司显示检测领域发展现状如何？

A：公司产品覆盖 LCD、OLED、Micro OLED、Mini/Micro-LED 全制程检测设备，国内市场占有率领先，深度配套京东方、TCL 华星光电、天马微电子、莱宝高科、维信诺、和辉光电、OPPO、惠科股份、视涯股份、显耀显示等国内主流面板厂商，以及三星、LG、Apple、Meta 等海外头部客户。报告期内，受益于消费领域头部客户 IT 类产品逐步使用 OLED 屏幕带来的行业风向标，国内龙头企业京东方、TCL 华星光电、维信诺 G8.6 OLED 项目的投建，LCD 大尺寸、超大尺寸扩线投资需求以及公司产品竞争力的进一步提升等多重因素叠加影响，公司在显示领域实现营业收入 84,329.52 万元，相较于去年同比增长 25.73%；实现归母净利润 7,298.13 万元，相较于去年同比增长 162.99%；公司在显示领域毛利率为 45.95%，较上年同期上升近 3 个百分点。截至《2026 年半年度报告》披露日，公司在显示领域在手订单约 12.28 亿元。

在新型显示以及智能和精密光学仪器领域，公司深度集成显示颜色测量技术、图像均匀性校准技术、高速数据处理技术、电性测试技术等核心能力，自研多款高端精密检测仪器，实现从传统显示到新型显示产线与实验室的全领域、全应用、全场景量检测服务覆盖。推出多点光谱增强色度计、多视角光谱测量仪、近眼显示高精度光谱仪、近眼显示色度计、近眼显示成像式光谱仪等智能光学仪器产品，攻克视角测量光谱偏移导致测量误差、多分区测量光谱失配等行业痛点，实现产品亮色度、光谱数据、视角、Gamma 调测、颜色均一性等测量，并系统展示多款精密光学/电学仪器，为复杂环境下的检测提供高效可靠的解决方案。现阶段部分精密光学/电学仪器已实现较大规模的销售，未来将对显示领域的快速发展提供重要的支撑。

报告期内，公司持续深耕 AR/VR 领域，聚焦海外头部客户核



心需求，依托精密仪器至光学检测系统全链条自主开发能力，构建起一站式全流程检测服务体系，为海外头部客户提供定制化、高可靠性的检测解决方案。公司凭借自主研发的核心技术优势，在海外 Top 客户的 VR 项目 Micro OLED 微显示、AR 项目 Display Engine 光引擎、Eyepiece 目镜模组及 FATP 整机组装制程检测等关键环节检测项目中深度合作，持续收获订单，彰显一站式自主服务核心竞争力，进一步巩固海外 AR/VR 检测领域市场地位，为业务全球化布局奠定坚实基础。

Q6：公司新能源设备领域发展现状如何。

A：现阶段，公司在新能源领域的主要产品为锂电池生产及检测设备，主要用于锂电池电芯组装配和检测环节等，包括锂电池切叠一体机、CT&XRAY 无损检测机、化成分容系统、CIR 组装配线、锂电池视觉检测系统和 BMS 检测系统等。报告期内，公司进一步加强与核心战略客户在锂电设备领域的深度合作，共同研发迭代产品，提升双方产业竞争力；同时，公司通过加强人员培训，优化调整组织结构及流程提升内生动力等多种举措，进一步提升公司核心竞争力。此外，公司正积极开拓与国内外知名电池厂商的合作关系，特别是海外核心客户的合作关系。报告期内，公司新能源板块实现扭亏为盈，依靠产品结构优化与生产精益管控，该板块实现成本稳步下行，营收稳步提升，经营状况持续向好，迎来盈利拐点。新能源领域实现销售收入 29,459.78 万元，较上年同比增长 146.05%；归母净利润 993.50 万元，相较于去年同期增加 4,083.55 万元，成功实现扭亏为盈。截至《2026 年半年度报告》披露日，公司在新能源领域在手订单约 7.52 亿元。

Q7：公司半导体业务股权及下属子公司布局介绍。

A：报告期内，公司持续推进业务结构优化，实施战略聚焦，将资源进一步向半导体核心业务倾斜。公司通过加大对半导体板块的资本投入、增持相关业务股权、强化下属子公司运营建设等方式，做强做优半导体主业，进一步聚焦半导体量检测业务。



精测电子投资者关系活动记录表（2026 年度）

	公司分别于 2026 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十二次会议，于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年度股东会，审议通过《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意公司与上海精积微部分股东签订《股权转让协议》。本次交易完成后，公司进一步提升半导体领域核心资产持股比例，将直接持有上海精积微 22.5355% 的股权，通过上海精测持有上海精积微 27.2168% 的股权，上海精积微仍为公司合并报表范围内公司。 公司已于 2026 年 7 月 16 日披露重大资产重组预案，拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买上海精测剩余 41.17% 股权并配套募资，目前相关工作正在稳步推进，公司会严格按照信息披露的规定和要求及时披露后续进展。本次交易完成后，上海精测将成为公司全资子公司，有利于进一步提高公司资产质量、增强业务上的协同性，公司持续经营能力和核心竞争力将得以进一步提升，并促进公司业务进一步聚焦半导体领域。 接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 8 月 27 日